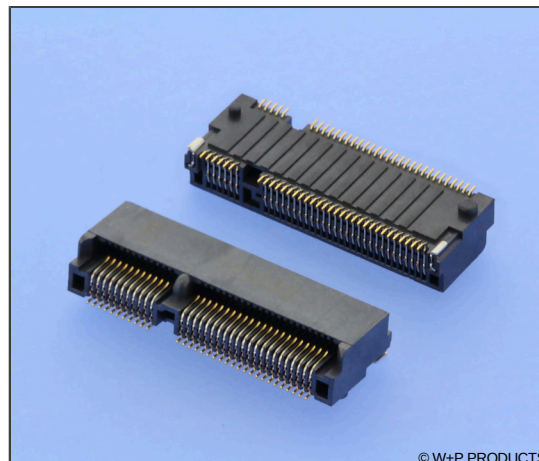


SMT M.2 (NGFF) Steckkartensockel RM 0,50mm - liegend

SMT M.2 (NGFF) Card Connector 0.50mm Pitch - horizontal

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche	Im Kontaktbereich vergoldet / Lötseite verzinnt (über Ni) (andere Veredelungen auf Anfrage)
<i>Contact Surface</i>	<i>Au plated contact area / Sn plated solder area (over Ni)</i> <i>(More plating options on request)</i>
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	<i>< 20 mΩ</i>
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	<i>> 500 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit	300 V AC
<i>Test Voltage</i>	<i>300 V AC</i>
Nennspannung	50 V AC
<i>Voltage Rating</i>	<i>50 V AC</i>
Nennstrom	0,5 A
<i>Current Rating</i>	<i>0.5 A</i>
Temperaturbereich	-40 °C ... +80 °C
<i>Temperature Range</i>	<i>-40 °C ... +80 °C</i>
Verarbeitung	Reflow 260 °C für 5 sec. max.
<i>Processing</i>	<i>Reflow 260 °C for 5 sec. max.</i>



© W+P PRODUCTS

Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	untere Temperaturangabe [°C]
Verweildauer oberhalb T_L	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	obere Temperaturangabe [°C]
Dauer Höchsttemperatur	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	Lower Temperature [°C]
Duration above T_L	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	Upper Temperature [°C]
Duration Peak Temperature	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

